

Title (en)  
TWO-MATERIAL MOLDING PROCESS AND DEVICE.

Title (de)  
ZWEIMATERIALIEN-GIESSVERFAHREN UND VORRICHTUNG.

Title (fr)  
DISPOSITIF ET PROCEDE DE MOULAGE A DEUX MATERIAUX.

Publication  
**EP 0233922 A1 19870902 (EN)**

Application  
**EP 86905129 A 19860818**

Priority  
US 77082085 A 19850828

Abstract (en)  
[origin: WO8701329A1] A dual injection molding method for producing two-material, two-component devices (46, 48). The method includes first, injection molding a first component (46) in one station (22) of a dual injection unit molding machine (10). The first component (46) is then transferred to a second station (24) in the machine (10) and a second component (48) is injection molded over the first component (46) such that the first component (46) acts as part of the mold (24) for the second component (48). The two components are maintainable in a fixed relationship to one another until they are manually separated. One feature of the invention is that a sterile barrier is formed between the first (46) and second (48) components as they are manufactured.

Abstract (fr)  
Le procédé de moulage à double injection ci-décrit permet de produire des dispositifs à deux composants, à deux matériaux (46, 48). Le procédé consiste premièrement à mouler par injection un premier composant (46) dans un poste (22) d'une machine de moulage (10) à double unité d'injection. Le premier composant (46) est ensuite transféré vers un second poste (24) de la machine (10) et un second composant (48) est moulé par injection sur le premier composant (46) de sorte que le premier composant (46) joue le rôle d'une partie du moule (24) pour le second composant (48). Les deux composants peuvent être maintenus fixe l'un par rapport à l'autre jusqu'à ce qu'on les sépare manuellement. Une caractéristique de l'invention est la formation d'une barrière stérile entre le premier composant (46) et le second composant (48) en cours de fabrication.

IPC 1-7  
**B29C 45/13**; **A61M 5/32**

IPC 8 full level  
**B29C 45/13** (2006.01); **A61M 5/158** (2006.01); **A61M 5/32** (2006.01); **B29C 45/14** (2006.01); **B29C 45/16** (2006.01); **B29L 23/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B29C 45/16** (2013.01); **B29C 45/162** (2013.01); **B29C 45/2681** (2013.01); **B29C 45/2756** (2013.01); **B29C 2045/1601** (2013.01)

Cited by  
US10132789B2

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8701329 A1 19870312**; CA 1268914 A 19900515; EP 0233922 A1 19870902; EP 0233922 A4 19871026; JP H0684029 B2 19941026; JP S63500651 A 19880310

DOCDB simple family (application)  
**US 8601694 W 19860818**; CA 516975 A 19860827; EP 86905129 A 19860818; JP 50445686 A 19860818